



アジアの中で生きる

友景 肇*

—昨年リーマンショックで、それまで自動車産業を中心として好調だった日本の景気は急激に悪化した。100年に一度の経済危機と呼ぶ人もいる。学会の催しへの企業からの参加者は減った。では今は、どうか。

世界全体で、半導体は好調である。生産の中心が日本から地球儀の上で西の方にずれただけで、世界的に半導体産業は成長過程にある。日本の素材メーカーや装置メーカーは、アジアを中心とした半導体製造地域への輸出が好調である。また、国内のIC生産も海外からの注文で、工場の稼働率は高い。つまり、国内での不景気感とは違う世界がある。景気は社会の「気」で、好調な一部の業界が社会に反して好調とはいえ、良くとも厳しいといわざるを得ない雰囲気がある。問題は、日本の半導体関連企業がどのようにして世界から仕事をとってくるか、ということである。半導体産業はグローバルな産業で、日々世界の企業同士でスピードと知恵の勝負をしており、国内の親会社から仕事が回ってくるのを待つという構造はすでない。

本学会は、半導体関連企業が主体の学会である。大学、研究機関に比べて企業所属の学会員が圧倒的に多い。景気という経済状況に敏感に反応する学会である。しかし、半導体産業は今不景気ではなく、世界で伸びている産業である。これから学会として目指すべき方向、使命とは何か。

半導体実装の新しい技術分野に焦点をあて、学術的興味で会員が楽しく集まれるコミュニティを提供することである。そして、このコミュニティを通して、会員および半導体関連企業が永続的に活動できるように支援することである。それを実現する1つの方策が、海外の半導体関連機関との連携および海外への情報発信と思われる。

2008年には、韓国のIMAPS Koreaと連携のためのMOUを締結したが、今後さらに海外機関、特にアジアの機関と研究者レベルでの連携を強めることが肝要と思われる。そのためには、日本からの情報発信が不可欠で、本学会でこれまで10年間にわたって開催されてきた国際会議International Conference on Electronics Packaging (ICEP)の意義は大きい。また、ICEPでの発表論文を中心に英語論文誌Transactions of The Japan Institute of Electronics Packagingが2008年から刊行されており、世界へ情報発信できるようになった。

近々に、日本全体で景気が回復といわれるようになるだろう。景気は変動し、上下することはあっても、日本の半導体関連企業の世界戦略は変わらない。どのようにして日本に仕事を持ってくるかである。学会からの海外への情報発信とアジアとの連携が、会員の所属する企業、さらには日本の半導体関連企業とベクトルが揃い、協調して発展することを目指したい。